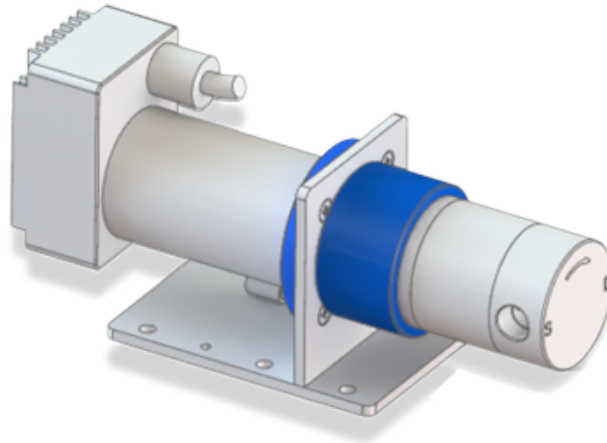


## Produktinformation

### Wärmedämmmodul · Ergänzungsmodule



#### Beschreibung

Mit dem Wärmedämmmodul lassen sich heiße Medien bis 150 °C fördern. Es beinhaltet eine thermisch dämmend ausgeführte Kupplungsbaugruppe aus Kunststoff (PEEK™) zwischen Pumpe und Antrieb. Die Wärmeübertragung von der Pumpe auf den temperaturempfindlichen Antrieb wird durch die Kunststoffabdeckung eingeschränkt. Eine Konvektionskühlung des Antriebs wird bei hohen Einschaltdauern und Medientemperaturen empfohlen.

#### Patente und Marken

Mikrozahnringpumpen (und Gehäuse) sind durch erteilte Patente geschützt: EP 1 354 135 B1; US 7,698,818 B2; DE 10 2011 001 041 B4; CN 103 348 141 B; US 10,012,220 B2; CN 103 732 921 B; US 9,404,492 B2; US 6,520,757 B1.

HNP M<sup>®</sup>, mzi<sup>®</sup>, MoDoS<sup>®</sup>, µ-Clamp<sup>®</sup>, µDispense<sup>®</sup>, Centifluidic Technologies<sup>®</sup>, LiquiDoS<sup>®</sup>, smartDoS<sup>®</sup>, ColorDoS<sup>®</sup> sind eingetragene deutsche Marken der HNP Mikrosysteme GmbH.

#### Kontakt

HNP Mikrosysteme GmbH  
Bleicherufer 25  
19053 Schwerin

T +49 385 52190-300  
F +49 385 52190-333  
info@hnp-mikrosysteme.de

Stand 2019/08